

Webinar:

❖ **PC Board Design for Low EMI.**

❖ **Benchtop Troubleshooting the Top Three EMC Issues.**

Fecha:

25 Junio 2021

Hora:

18:00 a 19:15

ESTA SESIÓN ES ABIERTA Y GRATUITA

Inscripción: Google Form

<https://forms.gle/b4oas33rEb4LaSKh9>

El link de la sala de streaming será enviado al correo el día de la presentación

WEBINAR EN IDIOMA INGLES sin traducción

**IEEE Argentina Section
EMC / Antennas
Chapter**

Disertante:

Ing. Kenneth Wyatt

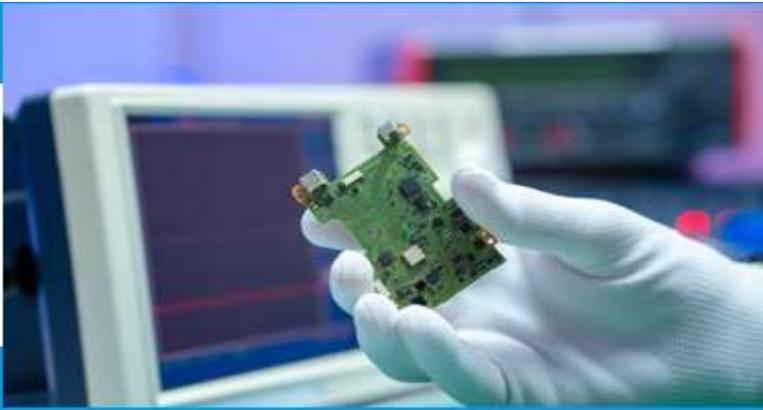


Resumen:

Kenneth Wyatt es consultor principal de Wyatt Technical Services LLC y se desempeñó durante tres años como editor técnico senior de Interference Technology Magazine de 2016 a 2018. Ha trabajado en el campo de la ingeniería de EMC durante más de 30 años con una especialidad en la resolución de problemas de EMI y pruebas de conformidad.

Es coautor de la popular Guía de bolsillo de EMC y RFI Radio Guía de bolsillo sobre interferencias de frecuencia. También fue coautor del libro con Patrick André, libro de cocina de solución de problemas de EMI para el producto. Recientemente publicó Creando su propio kit de resolución de problemas de EMC (Volumen 1), que es el primero de una serie sobre resolución de problemas y técnicas de prueba de cumplimiento previo que se pueden realizar en el banco de trabajo de forma interna. Es ampliamente publicado y es autor del blog de EMC alojado en EDN.com y continúa escribiendo para Interference Technology Magazine.

Ken es miembro senior del IEEE y miembro de la Sociedad EMC. Para ponerse en contacto con Ken o para obtener más información sobre artículos técnicos, programas de formación y enlaces, visite su sitio web: <http://www.emc-seminars.com>.



Webinar:

❖ **PC Board Design for Low EMI.**

❖ **Benchtop Troubleshooting the Top Three EMC Issues.**

TOPICOS DEL WEBINAR:

1) PC Board Design for Low EMI (Diseño de PCB para baja EMI)

La causa principal de muchos problemas de diseño gira en torno al diseño de la placa de circuito y cómo se organizan y distribuyen los conectores de E / S y de alimentación.

filtrado. Los diseños deficientes de las placas y la ubicación y el filtrado deficientes de las interconexiones pueden provocar emisiones radiadas, inmunidad radiada y fallas de cumplimiento de descargas electrostáticas (ESD), entre otras. Los malos diseños a menudo dan como resultado ciclos interminables de mitigación de prueba y error, pruebas de cumplimiento y giros de la placa. Esto alarga el cronograma y es muy costoso

2) Benchtop Troubleshooting the Top Three EMC Issues (Solución para los tres problemas principales de EMC)

Muchos de los problemas de EMC más desafiantes tienden a alternar interminablemente entre el intento interno de "soluciones" y luego fallar nuevamente en el laboratorio de pruebas de cumplimiento de terceros. Esto es una pérdida de tiempo y dinero.

Aprenda formas sencillas de analizar y mitigar los tres problemas principales de EMC y reducir el riesgo de fallas en las pruebas durante las pruebas de cumplimiento. Discutiremos cómo evaluar las emisiones radiadas rápidamente, cómo simular fallas de inmunidad radiada y trazar el camino

***IEEE Argentina Section
EMC / Antennas Chapter***